

資訊安全標準與應用

主辦單位:  台灣資通產業標準協會
Taiwan Association of Information and Communication Standards

共同主辦:  神盾股份有限公司
Egis Technology Inc.


協辦單位:  財團法人資訊工業策進會
INSTITUTE FOR INFORMATION INDUSTRY

 工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

贊助單位:  TWCA
臺灣網路認證

 ECO LUX

 ROHDE & SCHWARZ
Make it real

 TÜV Rheinland®
Precisely Right.

 TREND MICRO 趨勢科技

 電信技術中心
TELECOM TECHNOLOGY CENTER

近來資安議題備受關注，從這幾年大型資安攻擊事件來看，有諸多都源自於晶片資安漏洞所造成，故國際大廠也開始要求晶片資安設計與相關供應鏈的安全保障。晶片是物聯網(IoT)裝置的核心，隨著物聯網應用蓬勃發展，Gartner預測在2021年物聯網裝置的數量將達到250億個，故本活動將由晶片安全的面向切入，分享晶片資安設計技術，再延伸至物聯網的場域應用。本論壇將為產業帶來晶片資安設計技術最新發展，並進一步掌握資安產業趨勢脈動。

時間：2021.09.23(四) 10:00~14:40 (線上活動)

費用：定價3,000元，TAICS會員1,500元。

活動網址：<https://www.taics.org.tw/events/>



時間	議程	演講者
10:00~10:10	主席致詞	周勝鄰秘書長/台灣資通產業標準協會
10:10~10:40	#1: 台灣資安政策與公私合作規劃	李漢銘諮詢委員/國安會
10:40~11:00	#2: 推動國際合規的全方位台灣資安產業生態系統	詹東義副董事長/華邦電子股份有限公司
11:00~11:20	#3: Zero Trust 之晶片ID 標準	徐清祥董事長/力旺電子股份有限公司
11:20~11:40	#4: 車聯網晶片的難題與機會	林功藝營運長兼技術長/神盾股份有限公司
11:40~12:00	#5: 開啟晶片安全新旅程	徐達勇應用工程總監/安謀國際科技股份有限公司
12:00~13:00	中午休息	
13:00~13:20	#6: Who Are You? 身分識別的國際發展現況與未來的挑戰	黃維中副執行長/工研院巨資中心
13:20~13:40	#7: 智慧製造資安防護	蒙以亨所長/資策會智慧系統研究所
13:40~14:00	#8: 多層式物聯網資安佈局	蘇世賢資深解決方案架構師/台灣亞馬遜網路服務股份有限公司
14:00~14:20	#9: 安全電子設計自動化	賴育承董事長/尚承科技股份有限公司
14:20~14:40	#10: 行動身分識別服務	連子清產品總監/臺灣網路認證股份有限公司
14:40	賦歸	

註:主辦單位保留議程與講師變動權利。